

MÉTHODE DE PLAQUAGE TEMPORAIRE DE SUBSTRATS SOUPLES POUR LES MICROTECHNOLOGIES

NOUVELLE MÉTHODE DE RIGIDIFICATION TEMPORAIRE DE FILMS SOUPLES UTILISÉS DANS LA MICRO-ÉLECTRONIQUE

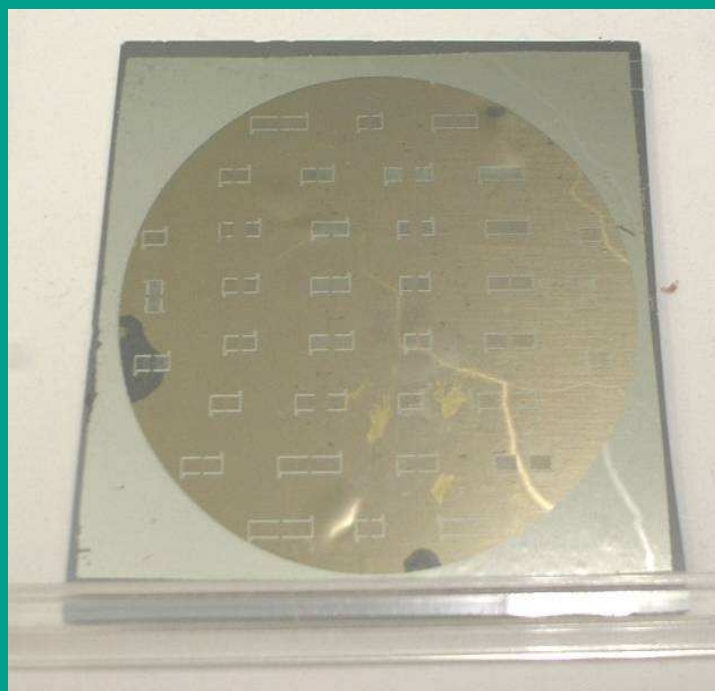
Cette nouvelle méthode de rigidification temporaire de films souples permet leur structuration, leur métallisation, le dépôt de couche par enduction centrifuge, le bain, l'impression (...), dans le but de modifier la surface dudit substrat. Cette structuration de films souples se fait de façon homogène sur de grandes surfaces.

AVANTAGES, INNOVATION

- ▶ Atteinte d'une précision de motif de l'ordre du μm par lithographie UV
- ▶ Homogénéité de la surface finale du produit obtenu
- ▶ Fait chuter le taux de rebut dans la fabrication
- ▶ Baisse du coût de fabrication
- ▶ Utilisation des équipements de microélectronique classique (substrat rigide) pour application sur substrat souple.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- ▶ Microélectronique sur substrat souple
- ▶ Microtechnologies, par exemple :
 - Capteurs souples de déformation, contrainte, vibration...
 - LED et OLED sur support souple



MOTS CLES

- ▶ Microtechnologies
- ▶ Microélectronique
- ▶ Support souple
- ▶ Homogénéité

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Savoir-faire secret

ÉTABLISSEMENT(S) IMPLIQUÉ(S)

Université de Lorraine / CNRS

Développé dans le cadre du projet ANR NANO-POP, ANR-PNAN02008-041

CONTACT :

Sandrine QUATRAVAUX
Ingénieur Valorisation Sciences des Matériaux
Tel: +333.54.50.41.64
Sandrine.quatravaux@univ-lorraine.fr